

배치설계의 등록표시에 관한 사항

반도체 집적회로의 배치설계에 관한 법률 제22조의 규정에 의한 배치설계의 등록표시에 관한 사항 및 동법시행규칙 제8조 제2항의 규정에 의한 비밀보호신청시 첨부서류의 제출방법을 다음과 같이 고시합니다.

1993년 10월 2일
특허청장

1. 반도체 집적회로의 배치설계에 관한 법률(이하 “법”이라 한다) 제22조의 규정에 의한 배치설계의 등록표시방법은 다음과 같다.
 - 가. 표시기호: “*배치*”, “ⓂIC” 또는 “*M*”의 기호중에서 선택하여 표시할 수 있음.
 - 나. 표시내용: 가항 표시기호에 병행하여 배치설계권자의 성명·명칭 또는 배치설계권의 등록번호를 표기할 수 있음.
 - 다. 표시위치: 설정등록된 배치설계를 이용하여 제조한 반도체집적회로 또는 그의 포장용기 등에 표시할 수 있음.
2. 이 법 시행규칙 제8조 제2항의 규정에 의한 비밀보호신청시 첨부서류의 제출방법은 다음과 같다.
 - 가. 배치설계의 상업적 이용의 연월일 전에 설정등록을 신청하는 경우에는 아래의 두가지 방법 중 하나를 선택하여 제출할 수 있음.
 - (1) 이 법 시행규칙 제7조의 규정에 의한 도면 또는 사진의 일부에 갈음하여 그 배치설계에 대하여 컴퓨터에 의한 설계형태의 수치를 기재한 서면을 마이크로 필름(마이크로피쉬 기타 이와 유사한 것을 포함한다)에 복사한 것을 제출하는 것.
 - (2) 그 배치설계의 특징을 현저히 곤란하게 하지 아니하는 범위내에서 이 법 시행규칙 제7조의 규정에 의한 도면 또는 사진의 일부를 보이지 아니하게 하여(이하 이 부분을 「비밀부분」이라 한다) 제출하는 것. 다만, 이 경우 비밀부분의 면적은 그 배치설계의 각층에 대하여 전체면적의 1/2을 초과할 수 없음.
 - 나. 배치설계의 상업적 이용의 연월일 이후에 설정등록을 신청하는 경우에는 가항의 서면 및 비밀부분을 포함하는 각층의 도면 또는 사진은 최상층의 배치설계로부터 기산하여 각 5층마다 2층 이내의 범위가 되도록 하여 제출하여야 함.

부 칙

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.